(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年2 月13 日 (13.02.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/011777 A1

(51) 国際特許分類7:

C03B 33/027, H01L 21/301

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/07320

(22) 国際出願日:

٦,

2002年7月18日(18.07.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-218146 2001年7月18日(18.07.2001) J

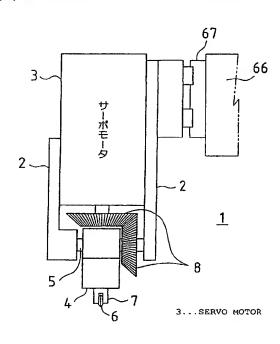
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三星ダイヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府吹田市 南金田 2 丁目 1 2番 1 2号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 若山 治雄 (WAKAYAMA,Haruo) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田 2 丁目 1 2番 1 2号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP). 酒井 敏行(SAKAI,Toshiyuki) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市南金田 2 丁目 1 2番 1 2号 三星ダイヤモンドエ

業株式会社内 Osaka (JP). 林 敬子 (HAYASHI, Keiko) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田 2 丁目 1 2番 1 2号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP). 西尾 仁孝 (NISHIO, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田 2 丁目 1 2番 1 2号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP). 松本潤一 (MATSUMOTO, Junichi) [JP/JP]; 〒564-0044 大阪府 吹田市 南金田 2 丁目 1 2番 1 2号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 倉内 義朗 (KURAUCHI,Giro); 〒530-0047 大 阪府 大阪市 北区西天満 4 丁目 1 4 番 3 号住友生命 御堂筋ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許

[続葉有]

- (54) Title: SCRIBE HEAD, SCRIBE APPARATUS AND SCRIBE METHOD USING THE SCRIBE HEAD
- (54) 発明の名称: スクライブヘッド及びそのスクライブヘッドを用いたスクライブ装置ならびにスクライブ方法



(57) Abstract: A scribe head (1) performs lifting/lowering of a scribe cutter by rotation of a servo motor (3) and transmits the rotation torque of the servo motor (3) as a scribe pressure to the scribe cutter. When scribing across a scribe line, the scribe pressure is temporarily increased when passing the scribe line. Moreover, the rotation torque of the servo motor (3) is controlled to be a predetermined limit value when the cutter (6) of the scribe head is at a position of movement along a substrate made of a brittle material. The servo motor (3) is position-controlled.

 特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI 特 許(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ 2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

(57) 要約:

本発明のスクライブヘッド1は、スクライブカッターの昇降をサーボモー タ3の回転により行い、かつ、サーボモータ3の回転トルクをスクライブカ ッターへのスクライブ圧として伝達する。スクライブラインを横切ってスク ライブする場合には、そのスクライブラインを通過するときに、一時的にス クライブ圧を高める。また、サーボモータ3の回転トルクは、スクライブへ ッドのカッター6が脆性材料基板上を移動する位置で、予め設定された制限 値に制御される。サーボモータ3は位置制御される。

明細書

スクライブヘッド及びそのスクライブヘッドを用いたスクライブ装置ならび にスクライブ方法

5

技術分野

本発明は、板ガラス、半導体ウエハ、セラミック等の脆性材料基板にスクライブラインを形成するスクライブヘッド及びそのスクライブヘッドを用いたスクライブ装置ならびにスクライブ方法に関する。

10

背景技術

図16は、従来におけるスクライブへッド50の構造を示す図であり、図17はその側面図を示す。カッターホイールチップ51を回転可能にするチップホルダ52は、ホルダ保持部54に設けた鉛直方向の軸受ベアリング55を介し首振り自在に設けられ、これにより、本スクライブへッド50の移動(図16では右方向の移動)に伴い、チップホルダ52はその移動方向に倣うように首を振る。

そのホルダ保持部54上には僅かなギャップGを隔ててスクライブユニット56が位置している。ホルダ保持部54の右側の所定部にベアリング57 が紙面に直交方向に埋め込まれ、そのベアリング57の中軸57aはスクライブユニット56側と一体となっている。そして、ホルダ保持部54の左下端部はストッパ53にて係止されている。これにより、ホルダ保持部54は、図示したギャップGの範囲内でベアリング57を支点として回動する。

スクライブユニット 5 6 内には上下方向に延在するエアシリンダ室 5 8 が 25 形成され、そのエアシリンダ室 5 8 内にはピストン 5 9 が嵌挿され、そのピストン 5 9 の下端部に形成した凹部にベアリング 6 0 が遊嵌状態に収められ、その中軸 6 0 a はピストン 5 9 に支持されている。従って、ベアリング 6 0 の外周体は自在に回転し、その下端部がホルダ保持部 5 4 に上方から当接している。ここでエアシリンダ室 5 8 に所定圧の空気を通じることにより、

ベアリング60とともにピストン59が下方に押下され、カッターホイール チップ51に所定のスクライブ圧(スクライブ荷重)が付与される。ベアリ ング60は、ホルダ保持部54が傾いた状況下にあっても、ピストン59よ りの押圧をホルダ保持部54に対して常に直下方向に伝えるためのものであ 5る。

このスクライブヘッド50は、図17に示すように、スクライブ装置66の水平方向のガイドレール67に沿って移動可能に設けられ、かつ、昇降シリンダまたはモータ65の駆動により、昇降自在となっている。スクライブヘッド50を下降させていくと、カッターホイールチップ51がガラス板Wに突き当たる。その後は、ベアリング57を支点としてホルダ保持部54が回動し、これにより、ストッパ53に間隙が生じると、これが検知され、スクライブヘッド50の降下が停止される。更に所定の切り込み量だけスクライブヘッド50が降下され、その後、エアシリンダ室58に所定のスクライブ圧が設定される。

15 図18に示した特開平8-225333号公報に開示された板ガラス切断装置20では、ガラスカッター38の昇降動作及び所望のスクライブ圧などを検出するために圧電素子を用いた検出部24を用い、その圧電素子で検出した信号を増幅部39、処理部26で処理し、そしてコントロール部28により、リニアモータ22を制御するようにしている。

20 しかしながら、図16のスクライブヘッド50では、カッターホイールチップ51を所定のレベルまで降下させるためのモータおよび所望のスクライブ圧を設定するために電空変換器などの複雑な機構が必要である。図18の装置においても検出部24やその検出信号を処理するための回路が必要となり、スクライブヘッドの機構が複雑である。また、移動子の慣性が大きいた25 め、応答性が悪く、スクライブ品質を安定させることが困難であった。

一方、電子部品材料として使用されるチップ状の方形ガラスは、1枚の大きなガラス板を母材とし、この母材から複数枚の方形ガラスに分断することで得られる。分断に際しては、まず、母材表面に対してカッターホイールチップを一方向に走行させる作業を走行開始位置を順次ずらせながら所定回数

繰り返して並列するスクライブラインを形成してから、今度はカッターホイールチップの走行方向を前回とは交差する方向に変えることで相互に交差するスクライブラインを形成するといったクロススクライブ作業を行う。次に、このようにしてクロススクライブされた母材をブレークマシンに送り、そこで母材に対して所定の圧力をかけ、母材に形成されたスクライブラインに沿って曲げモーメントを加えることにより母材をスクライブラインに沿って分断し、これにより目的とするチップ状の方形ガラスを得る。

上述したスクライブ作業に使用されるスクライブ装置としては、例えば図19に示されるような装置が公知である。なお、この図において左右方向を X方向、紙面に直交する方向をY方向として以下に説明する。

このスクライブ装置は、載置されたガラス板GLを真空吸着手段によって 固定する水平回転可能なテーブル70と、このテーブル70をY方向に移動 可能に支承する平行な一対の案内レール71,71と、この案内レール71 ,71に沿ってテーブル70を移動させるボールネジ72と、X方向に沿っ でテーブル70の上方に架設されたガイドバー73と、このガイドバー73 にX方向に摺動可能に設けられたスクライブへッド76と、このスクライブ ヘッド76を摺動させるモータ74と、スクライブへッド76の下部に昇降 動可能且つ首振り自在に設けられたチップホルダ77と、このチップホルダ 77の下端に回転可能に装着されたカッターホイールチップ78と、ガイド バー73の上方に設置されテーブル70上のガラス板GLに記されたアライ メントマークを認識する一対のCCDカメラ75とを備えたものである。

このような構成のスクライブ装置においては、ガラス板GL面に必然的に存在する微小な凹凸及びその他の要因によってスクライブヘッドの走行時にスクライブラインに歪みが生じるのを防ぐ工夫がスクライブヘッドに施されている。すなわち、図20に示すように、スクライブヘッド本体76Aにチップホルダ77をガラス板GL面と直交する回動軸79を介して回動軸79の軸心周りに揺動自在に設けるとともにこのチップホルダ77にカッターホイールチップ78を回動軸79の軸心位置Q₁よりも走行方向(図9において矢符S方向)とは逆方向にずれた位置Q₂に設けることで、スクライブへ

WO 03/011777 PCT/JP02/07320

ッド走行中、カッターホイールチップ78をスクライブへッド本体76Aに 追従させ、これによってカッターホイールチップ78の直進安定性を得て、 スクライブラインに歪みが発生するのを防止している。

ところが、前記のスクライブ装置にあっては、ガラス板にスクライブラインを一方向にのみ形成するときは何ら問題はないが、クロススクライブを行う場合、図21に示すように、最初に形成されたスクライブラインL₁~L₃をカッターホイールチップ 78が交差して通過する付近で、後から形成されるベきスクライブラインL₄~L₆が形成されない、いわゆる交点飛びと呼ばれる現象が発生していた。このような交点飛びがガラス板のスクライブ時に10 発生すると、上述したブレークマシンでガラス板を分断しようとする際、スクライブラインに沿ってうまくガラス板が分断されず、その結果不良品が大量に発生し、生産効率が極めて悪くなるといった問題があった。

このような問題が生じる原因は、カッターホイールチップが既存のスクライブラインを交差して通過するとき、スクライブヘッドに対してガラス板面 15 方向に加えられているスクライブに必要な力が、スクライブラインの両側に 潜在する内部応力によって削がれてしまうことにある。

そこで出願人は、前記の問題を解決するものとして、脆性材料基板上を走行するスクライブヘッド本体にチップホルダが脆性材料基板面と直交する回動軸を介して該回動軸の軸心周りに揺動自在に設けられるとともにこのチップホルダにカッターホイールチップが前記回動軸の軸心位置よりも前記走行方向とは逆方向に変位した位置に設けられてなるスクライブヘッドを使用し、脆性材料基板の表面にスクライブラインを相互に交差させて形成する場合において、スクライブ中、前記チップホルダを、その揺動範囲が0°より大きく2°以下の範囲となるように制御するようにしたスクライブ方法及びスクライブへッド並びにスクライブ装置を提案した(特願2000-142969号)。図22は、その一実施態様であるスクライブへッドの正面図、図23はその底面図である。

このスクライブヘッドは、スクライブヘッド本体80と、ベアリングケース81と、チップホルダ82と、カッターホイールチップ83と、付勢手段

84とを備えている。

スクライブヘッド本体80は、その下部が切り欠かれており、この切欠部85内にベアリングケース81が格納されている。ベアリングケース81は、その一端部が、スクライブヘッド本体80に挿通された水平な支軸86に5ベアリング87を介して連結される一方、他端部が、スクライブヘッド本体80内に支軸86と平行に設けられた制止軸88と当接されており、制止軸88によって制止される範囲内で支軸86の軸心周りに回動する。

チップホルダ82は、ベアリングケース81に、脆性材料基板面と直交する回動軸89を介して回動軸89の軸心周りに揺動自在に設けられている。

10 回動軸89とベアリングケース81との間にはベアリング40が介装されている。また、回動軸89の上方には付勢手段84が設けられており、この付勢手段84による付勢力が回動軸89及びチップホルダ82を介してカッターホイールチップ83に加えられるように構成されている。

カッターホイールチップ83は、チップホルダ82に、前記回動軸89の 15 軸心位置よりもスクライブヘッドの走行方向Sとは逆方向(図22において 左方向)に変位した位置に設けられている。

ここで、チップホルダ82は、スクライブ中、揺動範囲Aが0°よりも大きく2°以下に制御されるが、その制御手段としては、ベアリングケース81の下面に形成した溝41を利用している。すなわち、チップホルダ82を20 その上端部がベアリングケース81の溝41内に納まるように取り付け、チップホルダ82が揺動範囲の最大値まで揺動したときに、チップホルダ82の上端部における四隅の角のうちいずれか対角に位置する組の角42,45(43,44)が溝41の両内壁面46,47と当接するようにしている。これにより、溝41の両内壁面46,47とチップホルダ82の上端部における両側面48,49との間のクリアランスを調整することで、チップホルダ82の揺動範囲Aが前記所定範囲となるように調整できる。したがって、クリアランスを大きくとれば揺動範囲Aを大きくでき、逆にクリアランスを

出願人が提案したスクライブヘッドは、以上説明したような構成としたこ

小さくとれば揺動範囲を小さくできることになる。

WO 03/011777 PCT/JP02/07320

6

とにより、カッターホイールチップの直進性を維持しうるだけのチップホル ダの揺動動作を確保しつつ交点付近に潜在する内部応力の影響を抑えて動作 を確保できるものであるから、クロススクライブを行う際にスクライブへッ ドに対する加圧力を一定にしたままでも交点飛びが発生することがなく、ま 5 たスクライブ開始端においてスクライブラインが形成されないといったこと がなくなり所期の目的を達成することができるものである。

ところが、前記スクライブヘッドは、カッターホイールチップがチップホルダにその回動軸の軸心位置よりも走行方向とは逆方向に変位して設けられており、スクライブ時は支軸側を先頭にして走行されるものであるため、既10 設のスクライブラインと交差する時や、ガラスのうねりや反りあるいはガラス表面の凹凸を通過する時にカッターホイールチップが上方へ突き上げられ、チップホルダが支軸周りに回動してガラス面から浮き上がろうとする。図13は、その現象を説明するための模式図であり、符号GLはガラス、83はカッターホイールチップ、86は支軸をそれぞれ示している。

15 すなわち、支軸86を先頭にしてスクライブヘッドを走行させる(図中矢符S方向)と、カッターホイールチップ83の刃先稜線83Aがガラス面GLに接する点Pにおいて、走行方向に向かう摩擦力Mと、ガラスGLの厚み方向に向かう押圧力Nとの合力に対する反力Rがカッターホイールチップ83の中心側に向かって生じる。この反力Rは支軸86を中心とする回転モー20 メントとしてカッターホイールチップ83に作用し、その結果、カッターホイールチップ83は上方へ突き上げられることになり、図外チップホルダが支軸86周りに回動してガラス面GLから浮き上がろうとする。

上述したようなチップホルダの浮き上がり現象が生じると、カッターホイールチップ83への加圧力が前記反力Rにより削がれてしまうこととなり、25 その結果、深い垂直クラックが得にくくなるといった問題があった。

ところで、カッターホイールチップによりガラスに垂直クラックが発生するメカニズムをみてみると、まず刃先に荷重がかかることでガラス表面の刃 先と当接している箇所に弾性変形が生じ、次いで刃先荷重の増大に伴い前記 箇所に塑性変形が生じる。さらに刃先荷重が増大すると塑性変形の限界点を 超えることとなり、その結果脆性破壊が発生し、ガラスの厚み方向に垂直クラックが成長し始める。この垂直クラックの成長は、クラックの先端が、刃先荷重の大きさ及びガラスの材質や厚み等に応じた深度(脆性材料基板表面からの距離)にまで達した時点で終息する。これを、一定の材質、一定の厚ちのガラスについて見ると、前記垂直クラックの先端が達する深度(以下、垂直クラックの到達深度という。)をコントロールできるのは刃先荷重だけとなる。すなわち、刃先荷重を増大させるとカッターホイールチップの刃先がガラスの表面に食い込む深さが長くなり、垂直クラックを発生させるためのエネルギーが大きくなるため、垂直クラックの到達深度は深くなる。とこのエネルギーが大きくなるため、垂直クラックの到達深度は深くなる。とこのボ、刃先荷重がある一定の大きさを超えると、いわゆる深い垂直クラックが得られるもののそれと同時にガラスの表面付近に蓄積された内部歪みが飽和状態となり、垂直クラックの成長方向とは全く異なる方向に向かうクラック、いわゆる水平クラックが発生する。このような水平クラックは、望ましくない切り粉を多量に発生させる原因となる。

本発明者等は、前記したメカニズムをさらに詳しく探究した結果、刃先荷重と垂直クラックの到達深度とには図14に示すような関係があることを見出した。すなわち、この図14に示されたグラフからも分かるように、垂直クラックの到達深度は、刃先荷重が増大するに従って緩やかに深くなる領域(A領域)がまず存在し、これに続いて、刃先荷重の増大に伴って急激に増20 加する領域(B領域)が存在し、さらに刃先荷重が増大してもほとんど増加しない領域(C領域)が存在する。そして、このC領域では、A領域やB領域では見られなかった水平クラックが大幅に増加するのである。

以上のことから、B領域、つまり刃先荷重の増大に伴って急激に到達深度 Pが増加する領域内に相当する刃先荷重でスクライブすることによって、前 25 記水平クラックの発生を伴わずに深い垂直クラックを得られることを見出し た。

ところが、B領域の刃先荷重の範囲は極めて狭く、通常のスクライブ時に おける刃先荷重の調節ではB領域内だけで安定してスクライブすることは困 難であることが解った。特に、上述したように、従来技術ではチップホルダ の浮き上がり現象の発生を避けることができず、これによってカッターホイールチップへの加圧力が前記反力Rにより削がれてしまうことから、範囲が極めて狭い前記B領域内に刃先荷重を調節することは極めて困難であった。

また、クロススクライブにおいては、上述したように交点飛びの発生を防 5 止するため第2のスクライブラインの形成にあたって刃先荷重を第1のスク ライブライン形成時よりも大幅に増大させる必要があることから、刃先荷重 が往々にして前記C領域に入ってしまうこととなり、このため水平クラック の増加に伴う多量の切り粉の発生を避けることができないといった問題があ った。

10 さらに、前記したような問題とは別に、前記従来のカッターホイールを用いたスクライブでは、ガラスのうねりや反り、ガラス表面の凹凸、また、カッターホイールチップを保持するチップホルダやこのチップホルダを保持するスクライブヘッドのがたなどの外的要因により安定したスクライブラインが得られないことがしばしば発生していた。

15 本発明は、上述した課題を解決するためになされたもので、第1の目的は 簡単な機構であり、種々のスクライブ条件にも適宜対応できるスクライブへ ッド及びそのスクライブへッドを用いたスクライブ装置ならびにスクライブ 方法を提供することにある。第2の目的は、クロススクライブをする際に、 交点飛びが発生せず、チップホルダの浮き上がり現象を防止して、カッター 20 ホイールチップへの加圧力を効率よく脆性材料基板に作用させて、従来のも のよりも格段に深い垂直クラックを得ることができるスクライブへッド及び そのスクライブへッドを用いたスクライブ装置ならびにスクライブ方法を提 供することを目的とする。

25 発明の開示

上述の目的を達成するために、本発明のスクライブヘッドは、脆性材料基板にスクライブラインを形成するスクライブカッターを具備するスクライブヘッドにおいて、スクライブカッターの昇降をサーボモータの回転により行い、かつ、サーボモータの回転トルクをスクライブカッターへのスクライブ

圧として伝達することを特徴とする。

サーボモータを用いることにより、スクライブヘッドの機構が簡略化され、安価なスクライブヘッド及びスクライブ装置が提供できる。また、0点位置の検出もソフトウエア上で行なうことができ、従来の接点機構による0点 位置の検出も不要である。更に、スクライブ圧を発生させる機構の応答性が良いため、種々のスクライブ条件にもうまく対応できる。

この構成において、前記サーボモータの回転運動をギアを介して上下動に 変換し、かつ、回転トルクをスクライブ圧として作用させる構成としてもよ い。

10 また、スクライブ済みのスクライブラインを横切ってスクライブする場合には、そのスクライブラインを通過するときに、一時的にスクライブ圧を高める構成としてもよい。あるいは、前記サーボモータの回転トルクを、当該スクライブへッドのカッターが脆性材料基板上を移動する位置で、予め設定された制限値に制御されるようにすることが好ましい。また、前記サーボモータが位置制御されることが好ましい。この場合、前記サーボモータにより設定される脆性材料基板上面から下方の位置を、スクライブ開始と略同時にさらに下方へ設定することが好ましい。

このような構成とすれば、スクライブ済みの盛り上がったスクライブ跡を 横切る際のカッターホイールチップがジャンプするのを回避でき、いわゆる 20 交点飛び対策に有効である。

また、本発明の別のスクライブヘッドは、脆性材料基板上を走行するスクライブヘッド本体にチップホルダが脆性材料基板面と平行な支軸を介して該支軸の軸心周りに揺動自在に設けられるとともに、このチップホルダにカッターホイールチップが脆性材料基板面と平行な回転軸を介して該回転軸の軸25 心周りに回転自在に設けられた構成を特徴とするものである。

この別のスクライブヘッドは、上記のスクライブヘッドの構成を含むよう にしてもよい。

本発明のスクライブヘッドにおいて、前記チップホルダは、脆性材料基板 面と直交する回動軸を介して該回動軸の軸心周りに揺動自在に設けられてい ることが好ましい。

また、前記回転軸は、前記回動軸の軸心位置より前記支軸側寄りに変位して設けられていてもよい。

さらに、前記支軸の軸心が、前記カッターホイールチップがスクライブ中 5 に脆性材料基板から受ける反力のベクトル上のライン上又は該ラインよりも 上方に位置するよう配されていてもよい。

本発明のスクライブ装置は、脆性材料基板にスクライブラインを形成する スクライブカッターを具備するスクライブヘッドの移動により、脆性材料基 板をスクライブするスクライブ装置において、前記したスクライブヘッドの 10 いずれかが設けられていることを特徴とする。

また、本発明のスクライブ方法は、脆性材料基板上を走行するスクライブ ヘッド本体にチップホルダが脆性材料基板面と平行な支軸を介して該支軸の 軸心周りに揺動自在に設けられるとともに、このチップホルダにカッターホ イールチップが脆性材料基板面と平行な回転軸を介して該回転軸の軸心周り 15 に回転自在に設けられてなるスクライブヘッドを、前記支軸を前記カッター ホイールチップに対し後側にして脆性材料基板上を走行させて脆性材料基板 面にスクライブラインを形成することを特徴とする。

この構成において、前記チップホルダは、脆性材料基板面と直交する回動 軸を介して該回動軸の軸心周りに揺動自在に設けられていることが好ましい

20

さらに、前記回転軸は、前記回動軸の軸心位置より前記支軸側寄りに変位 して設けられていてもよい。

また、本発明のスクライブ方法において、前記カッターホイールチップが スクライブ中に脆性材料基板から受ける反力の方向が、該反力の起点と前記 25 支軸の軸心とを結ぶライン上もしくは該ラインより脆性材料基板寄りに存す る状態を維持しつつスクライブするようにしてもよい。

本請求の範囲第7項乃至第11項のスクライブヘッド及び本請求の範囲第12項乃至第15項のスクライブ方法では、前記したような特徴を有することにより、次のような作用を奏する。すなわち、図13に示すように、支軸

99を後側にしてスクライブヘッドを走行させる(図中矢符T方向)ことで、カッターホイールチップ95の刃先稜線95Aがガラス面GLに接する点 Eにおいて、走行方向に向かう摩擦力Vと、ガラスGLの厚み方向に向かう 押圧力Wとの合力に対する反力 X が生じるが、この反力 X は支軸99に向か 5 ものであって、カッターホイールチップ95を浮き上がらせるように作用 する回転モーメントとはならない。これにより、上述したようなチップホル ダの浮き上がり現象が発生せず、カッターホイールチップ95への加圧力が 前記反力 X により削がれてしまうことがない。その結果、カッターホイールチップ95への加圧力が効率よくガラス(脆性材料基板)に作用することと なり、従来のものよりも格段に深い垂直クラックを得ることが可能となる。

ここで、前記チップホルダは、脆性材料基板面と直交する回動軸を介して 該回動軸の軸心周りに揺動自在に設けられていてもよく、その場合は、チッ プホルダのスクライブヘッドの走行方向への追従性を向上させることができ 15 る。

さらに、前記回転軸は、前記回動軸の軸心位置より前記支軸側寄りに変位 して設けられていてもよく、この場合も、チップホルダのスクライブヘッド 走行方向への追従性をより高めることができる。

また、前記スクライブ方法及びスクライブへッドにおいては、カッターホ 20 イールチップがスクライブ中に脆性材料基板から受ける反力の方向が、該反 力の起点と支軸の軸心とを結ぶライン上もしくは該ラインより脆性材料基板 寄りに存する状態を維持するとよく、このようにすれば、上述したチップホ ルダを浮き上がらせる回転モーメントの発生をより確実になくすことが可能 となる。

25

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係る実施形態1のスクライブへッドの側面図であり、図 2はその主要部の正面図である。

図3は、本発明に係るスクライブヘッドの制御系を示す図である。

: . *

図4は、実施形態1のスクライブヘッドのカッターホイールチップのスクライブ時の動きを示す図である。

図5は、既に形成されたスクライブ線に対し直交してスクライブするとき の様子を示す構成図である。

5 図6は、本発明に係る別の実施形態を示すスクライブヘッドの図である。 図7は、本発明に係るスクライブヘッドの制御方法を示すフローチャート であり、1スクライブ動作を示す。

図8は、この制御方法における1スクライブ動作のタイミングチャートを X軸動作、Z軸動作及びZ軸トルクのそれぞれの変化を示す。

10 図9は、本発明に係るスクライブヘッドの実施形態2の正面図であり、図10は、その底面図である。

図11は、本発明に係る実施形態3のスクライブへッドの主要部を示す正面図である。

図12は、図11に示すスクライブ装置におけるスクライブへッドの他の 15 実施の形態を示す正面図である。

図13は、カッターホイールチップに生じる回転モーメントを説明するための模式図である。

図14は、従来のスクライブ方法における刃先荷重と垂直クラックとの関係を示すグラフである。

20 図15は、本発明における刃先荷重と垂直クラックとの関係を示すグラフである。

図16は、従来のスクライブヘッドの断面図、図17はこの側面図である

図18は、従来の別のスクライブヘッドの構成図である。

25 図 1 9 は、従来のスクライブ装置を示す概略正面図である。

図20は、従来の更に別のスクライブヘッドを示す概略図である。

図21は、交点飛びの現象を説明する図である。

図22は、従来の他のスクライブヘッドの正面図、図23はその底面図で ある。 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について図を参照しながら説明する。

<実施の形態1>

5 図1は、本発明の第1の実施形態を示すスクライブへッド1の側面図を示し、図2はその主要部の正面図を示す。

このスクライブヘッド1は、一対の側壁2間にサーボモータ3が倒立状態で保持され、その側壁2の下部には、側方から見てL字状のホルダー保持具4が支軸5を通じて回動自在に設けられている。そのホルダー保持具4の前10 方(図2中、右方向)には、カッターホイールチップ6を回転可能に支持するチップホルダ7が取り付けられている。

チップホルダ7は、その上端に設けられた回動軸17及びこの回動軸17 が挿通されるベアリング12を介してホルダー保持具4に取り付けられており、回動軸17の軸心周りに回動可能とされている。

15 カッターホイールチップ 6 は、チップホルダ 7 に、脆性材料基板面と平行な回転軸 1 3 を介して回転軸 1 3 の軸心周りに回転自在に、且つ、回転軸 1 3 がチップホルダ 7 の回動軸 1 7 の軸心に対して支軸 5 と反対側に変位して設けられている。

サーボモータ3の回転軸と支軸5とには、平傘歯車8が互いにかみ合うよ 0 うに装着されている。これにより、サーボモータ3の正逆回転により、ホル ダー保持具4は支軸5を支点として俯仰動作を行い、カッターホイールチッ プ6が上下動する。このスクライブヘッド1自体は、スクライブ装置66の 水平方向のガイドレール67に沿い移動可能に設けられている。なお、動力 伝達機構は平傘歯車8に限定されない。

25 図3は図1に示したスクライブヘッド1の制御系を示す図である。

エンコーダ9は、サーボモータ3の回転状況を検出するものである。サーボアンプ10はサーボモータ3を制御するものであり、エンコーダ9からの帰還信号に基づき、サーボモータ3に所定の駆動信号を送出する。上位コントローラ11は、スクライブヘッドの動作を制御するものであり、サーボア

ンプ10に対し、位置指令信号を供給する。

次に、図3の制御系における動作を、図4のカッターホイールチップのスクライブ時の動作を示す図を参照しながら説明する。

スクライブヘッド1が、スクライブ装置66のガイドレール67に沿って 移動することにより、スクライブヘッド1のカッターホイールチップ6は、 図4に示されるスタート点aへ移動し、0点位置(ガラス板Wの上面) から x だけ降下した切り込み位置へ移動させる指令が出されると、カッターホイールチップ6はその高さへ移動し、その位置で保持される。

更に、カッターホイールチップ6がガラス板Wに乗り上げる時のスクライ ブ圧P1を設定するために、モータ3の回転トルク(トルク制限値)を乗り上げトルク制限値P1に変更する。ただし、この回転トルクP1は刃先がガラス板Wに乗り上げる時に、基板端面に欠陥を及ぼさない値に設定する。

次に、スクライブヘッド1を予め設定されたガラス板Wへの乗り上げ速度で平行移動させ、b点でカッターホイールチップ6がガラス板Wに乗り上げた後、このbの位置からカッターホイールチップ6が予め設定された距離(b-c間)を移動し、c点で上位コントローラ11からの指令で回転トルク(トルク制限値)を押し込みトルク制限値P2に変更し、ガラス板Wの材質等に適したスクライブ圧をカッターホイールチップ6に伝える。

回転トルクP2(>P1)が設定され、カッターホイールチップ6に所望20 のスクライブ圧が設定されると、予め設定されたスクライブ速度でスクライブへッド1は移動する。回転トルクとスクライブ圧との関係は予め計測して換算テーブルを作成しておく。

カッターホイールチップ 6 が d 点に達すると、前記スクライブ速度から予め設定されたガラス板Wからの切り抜ける速度にスクライブヘッド 1 は減速 される。そして、回転トルク(トルク制限値)は切り抜けトルク制限値P 3 (<P 2)に変更される。なお、P 3 は乗り上げ時と同様にガラスの端部に 欠陥を与えない低いトルクである。その状態で e 点まで進む。 e 点でガラス板Wから抜け出ると、回転トルクが位置決めトルクに変更されることにより、カッターホイールチップ 6 の高さは再び切り込み位置で保持される。この

1 5

状態で f 点まで移動すれば、一連のスクライブが終了する。

回転トルク P 1、 P 3 をスクライブ時の回転トルク P 2 より小さくしたのは、カッターホイールチップ 6 がガラス板Wへ乗り上げる時やそこから抜け出る時に、ガラス板Wに不用なクラックを発生させないための措置である。

5 a 点から f 点のそれぞれの座標データはガラス板Wのサイズに応じて予め設 定しておく。

以上のように、本実施形態のスクライブヘッド1では、サーボモータ3の 回転トルクをスクライブ圧としてダイレクトに作用させる機構としたので、 応答性が極めてよく、従って、次のようなスクライブも可能になる。

10 図 5 はスクライブ済みのガラス板Wに対し、更に直交方向にスクライブする様子を示しており、盛り上がったスクライブ跡を横切る時に、カッターホイールチップ 6 はそこでジャンプするため、スクライブラインが連続しないスクライブ欠陥が発生することがある。この問題を回避するには、スクライブ跡を横切る時に、スクライブ圧を一時的に高めればよいことがわかっている。

本実施形態のスクライブヘッド1では、スクライブ圧を瞬時に変更することが可能なため、形成しようとするスクライブラインが交差して交点となる個所の位置データを予め入力しておき、スクライブヘッド1の移動時に、その交点を通過する毎にスクライブ圧を瞬間的に加減するようにすればよい。

20 以上のようなサーボモータスクライブヘッドを用いて脆性材料基板をスクライブする際、サーボモータスクライブヘッド(スクライブヘッド1)を位置制御する制御方法をさらに詳しく説明する。

まず、図7は、1スクライブ動作におけるこのサーボモータスクライブへ ッド(スクライブヘッド1)の制御方法を示すフローチャートであり、図8 25 は、1スクライブ動作のタイミングチャートをX軸動作(スクライブヘッド が基板上を移動する動作)、Z軸動作(スクライブヘッドに取付けられたカ ッターホイールチップの動作)及びZ軸トルク(サーボモータの回転トルク)のそれぞれの変化を経時的対応で示す。

これらの図では、カッターが基板上を左から右へ移動(その移動方向に位

置データは増加する)し、X軸の位置データが増加する方向にスクライブを 行なったときの例を示す。本実施形態では、X軸の位置データに基づいてZ 軸トルクを制御する点が特徴となっている。

まず、X軸の位置データとしては、X軸動作開始位置及びX軸動作終了位 5 置の間に、X軸起動位置、X軸切込位置、X軸押込終了位置、X軸切込終了 位置、X軸スクライブ終了位置のそれぞれのデータが設定される。X軸切込 位置とX軸押込終了位置の間で、サーボモータを制御するサーボアンプのI N-POS(インポジ)信号のOFF検出が行なわれ、カッターホイールチッ プが基板上へ完全に乗り上げたことが確認される。X軸切込位置データは、 スクライブ動作中に、Z軸(カッターホイールチップ)を切込位置に移動さ 10 せるX軸のポイントである。X軸押込終了位置データは、スクライブ動作中 に、Z軸(カッターホイールチップ)を押込位置から切込位置に移動させる X軸のポイントである。そして、X軸切込終了位置データは、スクライブ動 作中に、Z軸(カッターホイールチップ)を切込位置から待機位置に移動さ せるX軸のポイントである。また、Z軸トルクに関する設定データには、以 下の制限値が設定される。スクライブ中に、カッターホイールチップがガラ スへ乗り上げる時のトルク制限値である乙軸乗り上げトルク制限値、スクラ イブ中に、カッターホイールチップがガラスから抜ける時のトルク制限値で あるZ軸切り抜けトルク制限値、カッターホイールチップが基板上へ完全に 20 乗り上げてからカッターホイールチップの押込を終了するまでのトルク制限 値であるZ軸押込トルク制限値、そして、カッターホイールチップを位置決 めするときのトルク制限値であるZ軸位置決めトルク制限値がある。

1スクライブ動作におけるこの制御方法は、図7に示すように、まず、Z軸位置決めトルク制限値を設定し出力する(STEP.1)。次に、カッターホイ25 ールチップをZ軸待機位置(図8中Z1)に移動させる(STEP.2)。X軸動作が切込位置以上である場合、Z軸切込位置(図8中Z2)にカッターホイールチップを移動させる(STEP.3)。次に、Z軸乗り上げトルク制限値を設定し出力する(STEP.4)。

尚、カッターホイールチップが脆性材料基板上に乗り上げる時、Z軸切込

17

位置のカッターホイールチップの位置がズレるため、サーボモータはサーボアンプから出力されるIN-POS (インポジ) 信号がONであっても、カッターホイールチップの位置を元のZ軸切込位置へ戻そうとする。このため、サーボモータが元の位置へ戻そうとするトルクを制限する必要が生じて、

- 5 乙軸乗り上げトルク制限値を設定する。また、乙軸乗り上げトルク制限値はカッターホイールチップが脆性材料基板に乗り上げる時に、脆性材料基板の端部に欠けを生じさせないような低いトルク値に設定される。そして、サーボアンプから出力されるIN-POS (インポジ) 信号がOFFの場合には、乙軸押込トルク制限値を設定し出力する (STEP. 5)。
- 10 次に、Z軸押込位置に(図8中Z3)にカッターホイールチップを移動させる(STEP.6)。通常、Z軸切込位置は脆性材料基板上面から O. 05mm~O. 20mm下方に設定される。サーボアンプから出力される I N-POS (インポジ) 信号がOFFになり、カッターホイールチップが脆性材料基板上に乗り上げたことが確認されると、Z軸押込トルク制限値として設定されたトルクにより、脆性材料基板がスクライブされる。このとき、Z軸の位置がZ軸切込位置のままであると変位が少ないため、スクライブに適切な押込トルクを得ることが出来ない(トルクがZ軸押込トルク制限値に達しない)。このため、Z軸の位置を脆性材料基板の上面からZ軸切込位置よりもさらに下方にZ軸押込位置として設定し、種々の脆性材料基板をスクライブするのに適したZ軸押込トルク制限値が得られるようにする。

次に、スクライブヘッドのX軸移動位置がX軸押込終了位置データ以上の位置になった場合、Z軸切り抜けトルク制限値を設定し出力し、Z軸の位置をZ軸切込位置にする。Z軸切り抜けトルク制限値はカッターホイールチップが脆性材料基板から切り抜ける時に、脆性材料基板の端部に欠けを生じさせないような低いトルク値に設定される(STEP.7)。そして、スクライブヘッドがX軸切込終了位置データ以上の位置になった場合、Z軸位置決めトルク制限値を設定し出力する(STEP.8)。そして、カッターホイールチップをZ軸待機位置(図8中Z1)に移動する(STEP.9)。その後、X軸動作が切込位置以下となった場合、スクライブ動作のデータを格納した後、リセットされ

18

(STEP. 10)、1スクライブの動作は終了する。

このように、位置制御されるサーボモータにより設定された位置がズレたときに、サーボモータによる設定位置へ戻すように働く回転トルクを制限して、脆性材料基板をスクライブするのであるが、脆性材料基板の端部に欠けを生じさせずに、良質のスクライブラインを得るためには、一旦設定した Z 軸の位置をスクライブ開始と略同時に、脆性材料基板の上面からさらに下方へ設定することが必要となる。

なお、図7のフローチャートにおいては、スクライブヘッドが基板上をそ の移動方向に対して位置データが増加する場合を記載したが、X軸の位置デ 10 ータが減少する方向にスクライブを行なう場合は、判断を示す処理記号内の 「以上」、「以下」の用語はそれぞれ「以下」、「以上」の用語に置き換え て処理を行なう。 このような一連の処理は、図8に示すタイミングチャー トに表すことができる。つまり、スクライブヘッドが起動し、X軸切込位置 においては、それまで待機位置(Z1)に位置していたカッターホイールチ 15 ップは Z 軸トルクを Z 軸位置決めトルク制限値としながら Z 軸切込位置 (Z 2) に移動する。そして、サーボアンプのIN-POS (インポジ) 信号の OFFが検出されるまで、Z軸の設定位置はZ軸切込位置(Z2)とされ、 Z軸トルクはZ軸乗り上げトルク制限値に維持される。サーボアンプの IN - POS (インポジ) 信号のOFFが検出された後は、X軸押込終了位置ま 20 で、2軸の設定位置は2軸押込位置(23)とされ、2軸トルクは2軸押込 トルク制限値に維持される。そして、X軸押込終了位置からX軸切込終了位 置までの間、乙軸の設定位置は乙軸切込位置(乙2)とされ、乙軸トルクは 乙軸切りぬけトルク制限値に維持される。その後さらに、X軸スクライブ終 了位置からは初期状態にリセットされる。

25 以上のように、サーボモータスクライブヘッドの制御方法に位置制御を採用したため、スクライブヘッドの移動に応じて、適宜、予め設定された回転トルクの制限値に変更しながら脆性材料基板をスクライブすることが可能であり、制御に用いられるプログラムも比較的容易なものとすることができる

本実施形態では、図1のように、動力伝達機構としては平傘歯車8を用いてホルダ保持具4へ動力を伝えたが、図6のようにサーボモータ3の回転軸をホルダ保持具4に直結した構成にしてもよい。

本実施形態では脆性材料基板の一種であるガラス板をスクライブするため のスクライブカッターとして、超硬合金製またはダイヤモンド製のカッター ホイールチップをスクライブヘッドに具備する一例を説明したが、スクライ ブヘッドに具備するスクライブカッターとしては、前記のカッターホイール チップに限らず、ダイヤポイントや円形状の刃先稜線の両側を円錐または円 錐台状に加工されたカッターなど、脆性材料基板にスクライブラインを形成 10 するカッターが含まれる。

次に、請求の範囲第7項乃至第9項のスクライブヘッド及び第13項乃至 第16項のスクライブ方法の実施の形態を、図面を参照して説明する。なお 、本発明に係るスクライブ方法は、スクライブヘッドにおいて実施されるも のであるため、ここではスクライブヘッドについての実施の形態の説明のな かでスクライブ方法の実施の形態についても説明する。

<実施の形態2>

図9は、本発明に係るスクライブヘッドの実施の形態2の正面図、図10はその底面図である。

スクライブヘッド90は、スクライブヘッド本体92と、ベアリングケー 20 ス93と、チップホルダ94と、カッターホイールチップ95と、付勢手段 96とを備えている。

スクライブヘッド本体92は、その下部が切り欠かれており、この切欠部98内にベアリングケース93が格納されている。ベアリングケース93は、その一端部が、スクライブヘッド本体92に挿通された水平な支軸99に ベアリング900を介して連結される一方、他端部が、スクライブヘッド本体92内に支軸99と平行に設けられた制止軸91と当接されており、制止軸91によって制止される範囲内で支軸99の軸心周りに回動する。

チップホルダ94は、ベアリングケース93に、脆性材料基板面と直交する回動軸97を介して回動軸97の軸心周りに揺動自在に設けられている。

回動軸97とベアリングケース93との間にはベアリング901が介装されている。また、回動軸97の上方には付勢手段96が設けられており、この付勢手段96による付勢力が回動軸97及びチップホルダ94を介してカッターホイールチップ95に加えられるように構成されている。

5 なお、チップホルダ94は、上述のように必ずしも回動軸97の軸心周り に揺動自在に設けられる必要はなく、ベアリングケース93に対して固定されていてもよい。その場合は、ベアリング901等の揺動に必要な部材を省略すればよい。

カッターホイールチップ95は、チップホルダ94に、脆性材料基板面と で行な回転軸913を介して該回転軸913の軸心周りに回転自在に、且つ 、回転軸913が前記回動軸97の軸心位置より支軸99側寄りに変位して 設けられている。 なお、カッターホイールチップ95と回動軸97との位置関係は前記した関係に限るものではなく、カッターホイールチップ95の 回転軸913が、回動軸97の軸心の直下に位置していてもよい。

- 上記のスクライブヘッド90によりスクライブを実施するにあたっては、 支軸99をカッターホイールチップ95に対し後側にしてスクライブヘッド 90を脆性材料基板上を走行させる。つまり、図9における矢符Tで示す方 向にスクライブヘッド90を走行させる。このように支軸99をカッターホ イールチップ95に対し後側にしてスクライブヘッドを走行させることで、
- 20 図13に示すように、カッターホイールチップ95の刃先稜線95Aがガラス面GLに接する点Eにおいて、走行方向に向かう摩擦力Vと、ガラスGLの厚み方向に向かう押圧力Wとの合力に対する反力Xが生じるが、この反力Xは支軸99に向かうものであって、カッターホイールチップ95をガラスGLから浮き上がらせるように作用する回転モーメントとはならない。これ
- 25 により、上述したようなチップホルダの浮き上がり現象が発生せず、カッターホイールチップ95への加圧力が反力Xにより削がれてしまうことがない。その結果、カッターホイールチップ95への加圧力が効率よく脆性材料基板に作用することとなり、従来のものよりも格段に深い垂直クラックを得ることが可能となるのである。

ここで、図13に示すように、カッターホイールチップ95がスクライブ中に脆性材料基板GLから受ける反力Xの方向が、該反力Xの起点Eと支軸99の軸心とを結ぶラインH上もしくは該ラインHより脆性材料基板GL寄りに存する状態を維持するとよく(図13中、点線矢符X1,W1,V1参照5)、このようにすれば、上述したチップホルダを浮き上がらせるような回転モーメントの発生をより確実になくすことが可能となる。当該状態を維持するにあたっては、スクライブ速度、カッターホイールチップ95に対する加圧力、カッターホイールチップ95と支軸99との相対位置関係を適宜調整することで行うことができる。

10 <実施の形態3>

25

次に、本発明の実施の形態3について図11を参照して説明する。

図11はスクライブヘッドの主要部の正面図であり、その側面図は図1と同様に表わされるので省略する。

このスクライブヘッド1は、一対の側壁2間にサーボモータ3が倒立状態 15 で保持され、その側壁2の下部には、側方から見てL字状のホルダー保持具 4が支軸5を通じて回動自在に設けられている。そのホルダー保持具4の前 方(図11中、右方向)には、カッターホイールチップ95を回転可能に支 持するチップホルダ94が取り付けられている。

チップホルダ94は、その上端に設けられた回動軸17及びこの回動軸1 20 7が挿通されるベアリング12を介してホルダー保持具4に取り付けられて おり、回動軸17の軸心周りに回動可能とされている。

カッターホイールチップ95は、上述の実施の形態2の場合と同様、チップホルダ94に、脆性材料基板面と平行な回転軸13を介して該回転軸13 の軸心周りに回転自在に、且つ、回転軸13がチップホルダ94の回動軸17の軸心位置より支軸5側寄りに変位して設けられている。

サーボモータ3の回転軸と支軸5とには、平傘歯車8が互いにかみ合うように装着されている。これにより、サーボモータ3の正逆回転により、ホルダー保持具4は支軸5を支点として俯仰動作を行い、カッターホイールチップ95が上下動する。このスクライブヘッド自体は、スクライブ装置66の

水平方向のガイドレール67に沿い移動可能に設けられている (図1参照) 。なお、動力伝達機構は平傘歯車8に限定されない。

なお、本実施の形態においては、動力伝達機構として平傘歯車8を用いて ホルダー保持具4への動力を伝えたが、図12に示すように、サーボモータ 3の回転軸をホルダー保持具4に直結した構成にしてもよい。

ここで、図13に示すように、カッターホイールチップ95がスクライブ 中に脆性材料基板GLから受ける反力Xの方向が、該反力Xの起点Eと支軸 9 9の軸心とを結ぶラインH上もしくは該ラインHより脆性材料基板GL寄 りに存する状態を維持するとよく(図13中、点線矢符X1, W1, V1参照 10)、このようにすれば、カッターホイールチップ95を浮き上がらせような 回転モーメントの発生をより確実になくすことが可能となる。当該状態を維 持するにあたっては、スクライブ速度、カッターホイールチップ95に対す。 る加圧力、カッターホイールチップ95と支軸99との相対位置関係を適宜 調整することで行うことができる。

次に、本発明に係るスクライブ方法と従来のスクライブ方法とをそれぞれ 実施し、ガラスに形成された垂直クラックの深さを測定した。

(実施例)

本発明に係るスクライブ方法については、図12に示すスクライブへッド を用いて、次の条件でスクライブを行った。

カッターホイールチップのホイール径 2.5mm 20 カッターホイールチップのホイール厚 0.65mm カッターホイールチップの刃先角度 125°

スクライブ速度 300mm/sec

刃先荷重

1. 1 kgf

ガラスの材質 ソーダガラス 25

ガラスの厚み 0.7mm

スクライブヘッドの走行方向 図12において矢符T方向

(比較例)

比較として、スクライブヘッドの走行方向を従来通り、つまり図12にお

いて矢符Sの方向としてその他は、前記本発明の実施例と同条件で行った。 但し、カッターホイールチップ95の回転軸913が、走行時に回動軸97 の後側に位置するようチップホルダ94の向きを前記実施例とは逆にした。 (測定結果)

5 前記各方法でスクライブした後、それぞれについて垂直クラックの深さを 測定したところ、次の結果を得た。

実施例 450μm~500μm

比較例 110μm~120μm

以上の結果からも明らかなように、本発明によるスクライブ方法及びスク 10 ライブヘッドによれば、同じ刃先荷重で、従来の約4倍以上の垂直クラック が得られることが解る。

産業上の利用可能性

サーボモータを用いることにより、スクライブヘッドの機構が簡略化され、安価なスクライブヘッド及びスクライブ装置が提供できる。また、0点位置の検出もソフトウエア上で行なうことができ、従来の接点機構による0点位置の検出も不要である。更に、スクライブ圧を発生させる機構の応答性が良いため、種々のスクライブ条件にもうまく対応できる。

また、クロススクライブを行う際に交点飛びが発生することがないのは勿 20 論のこと、チップホルダの浮き上がりが発生しないので、カッターホイール チップへの加圧力を効率よく脆性材料基板に作用させて従来のものよりも格 段に深い垂直クラックを得ることができる。したがって、クロススクライブ 後における分断工程において、スクライブラインに沿って精確にガラス板を 分断することができ、不良品の発生をなくして生産効率を従来に比べて格段 25 に向上させることができる。

請求の範囲

- 1. 脆性材料基板にスクライブラインを形成するスクライブカッターを具備するスクライブヘッドにおいて、スクライブカッターの昇降をサーボモー 5 タの回転により行い、かつ、サーボモータの回転トルクをスクライブカッタ ーへのスクライブ圧として伝達することを特徴とするスクライブヘッド。
 - 2. 前記サーボモータの回転運動をギアを介して上下動に変換し、かつ、回転トルクをスクライブ圧として作用させることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載のスクライブヘッド。
- 10 3. スクライブ済みの当該スクライブラインを横切ってスクライブする場合には、そのスクライブラインを通過するときに、一時的にスクライブ圧を高めることを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載のスクライブへッド。
- 4. 前記サーボモータの回転トルクを、当該スクライブヘッドのカッター 15 が脆性材料基板上を移動する位置で、予め設定された制限値に制御されることを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載のスクライブヘッド。
 - 5. 前記サーボモータが位置制御されることを特徴とする請求の範囲第1 項乃至第4項のいずれか一つに記載のスクライブへッド。
- 6. 前記サーボモータにより設定される脆性材料基板上面から下方の位置 20 を、スクライブ開始と略同時にさらに下方へ設定することを特徴とする請求 の範囲第5項に記載のスクライブヘッド。
- 7. 脆性材料基板上を走行するスクライブヘッド本体にチップホルダが脆性材料基板面と平行な支軸を介して該支軸の軸心周りに揺動自在に設けられるとともに、このチップホルダにカッターホイールチップが脆性材料基板面と平行な回転軸を介して該回転軸の軸心周りに回転自在に設けられたことを特徴とするスクライブヘッド。
 - 8. 脆性材料基板上を走行するスクライブヘッド本体にチップホルダが脆性材料基板面と平行な支軸を介して該支軸の軸心周りに揺動自在に設けられるとともに、このチップホルダにカッターホイールチップが脆性材料基板面

と平行な回転軸を介して該回転軸の軸心周りに回転自在に設けられたことを 特徴とする請求の範囲第1項乃至第6項のいずれか一つに記載のスクライブ ヘッド。

- 9. 前記チップホルダは、脆性材料基板面と直交する回動軸を介して該回 5 動軸の軸心周りに揺動自在に設けられていることを特徴とする請求の範囲第 7項または第8項に記載のスクライブヘッド。
 - 10. 前記回転軸は、前記回動軸の軸心位置より前記支軸側寄りに変位して設けられていることを特徴とする請求の範囲第9項に記載のスクライブへッド。
- 10 11. 前記支軸の軸心が、前記カッターホイールチップがスクライブ中に 脆性材料基板から受ける反力のベクトル上のライン上又は該ラインよりも上 方に位置するよう配されたことを特徴とする請求の範囲第7項乃至第10項 のいずれか一つに記載のスクライブヘッド。
- 12. 脆性材料基板にスクライブラインを形成するスクライブカッターを 15 具備するスクライブヘッドの移動により、脆性材料基板をスクライブするス クライブ装置において、請求の範囲第1項乃至第11項のいずれか一つに記 載のスクライブヘッドが設けられていることを特徴とするスクライブ装置。
 - 13. 脆性材料基板上を走行するスクライブヘッド本体にチップホルダが 脆性材料基板面と平行な支軸を介して該支軸の軸心周りに揺動自在に設けら
- 20 れるとともに、このチップホルダにカッターホイールチップが脆性材料基板面と平行な回転軸を介して該回転軸の軸心周りに回転自在に設けられてなるスクライブヘッドを、前記支軸を前記カッターホイールチップに対し後側にして脆性材料基板上を走行させて脆性材料基板面にスクライブラインを形成することを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。
- 25 14. 前記チップホルダは、脆性材料基板面と直交する回動軸を介して該 回動軸の軸心周りに揺動自在に設けられていることを特徴とする請求の範囲 第13項に記載の脆性材料基板のスクライブ方法。
 - 15. 前記回転軸は、前記回動軸の軸心位置より前記支軸側寄りに変位して設けられていることを特徴とする請求の範囲第14項に記載の脆性材料基

板のスクライブ方法。

16. 請求の範囲第13項乃至第15項のいずれか一つに記載の脆性材料 基板のスクライブ方法において、前記カッターホイールチップがスクライブ 中に脆性材料基板から受ける反力の方向が、該反力の起点と前記支軸の軸心 5 とを結ぶライン上もしくは該ラインより脆性材料基板寄りに存する状態を維 持しつつスクライブすることを特徴とする脆性材料基板のスクライブ方法。

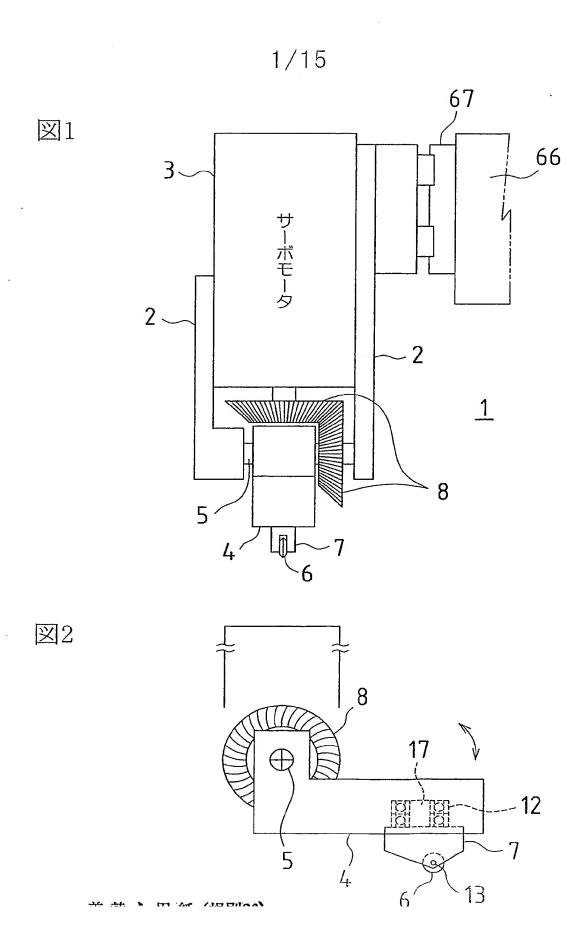
10

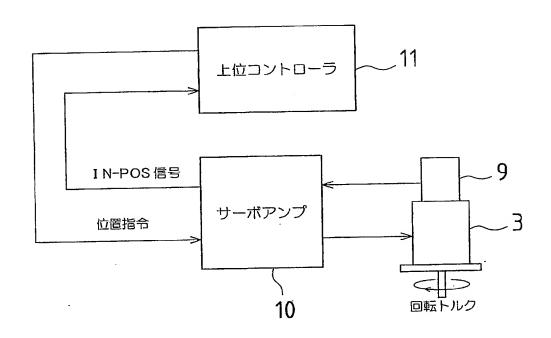
15

20

25

WO 03/011777 PCT/JP02/07320





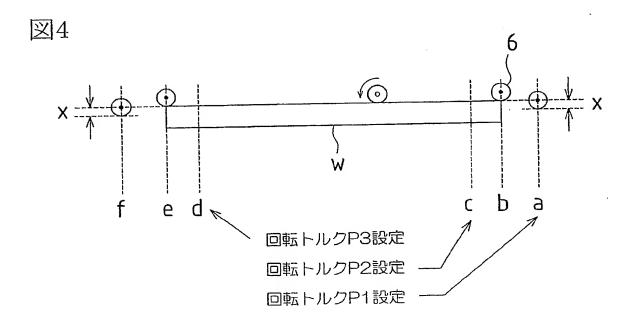
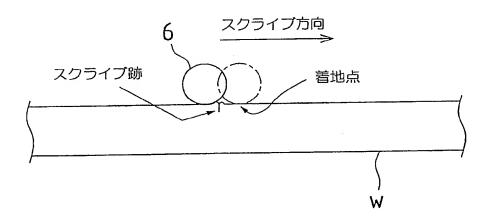
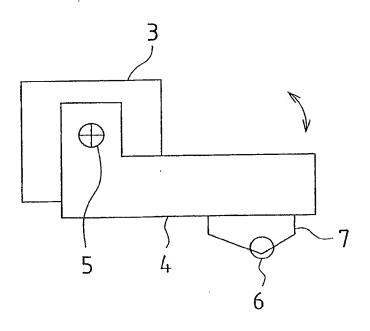
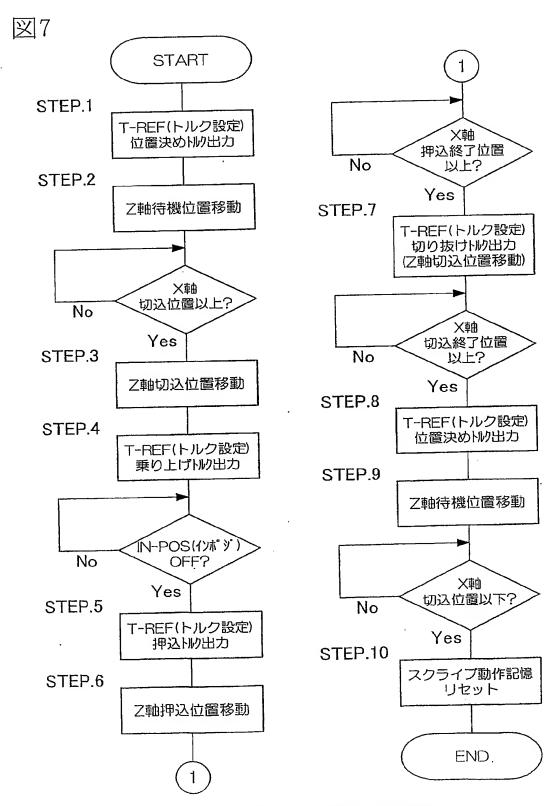


図5

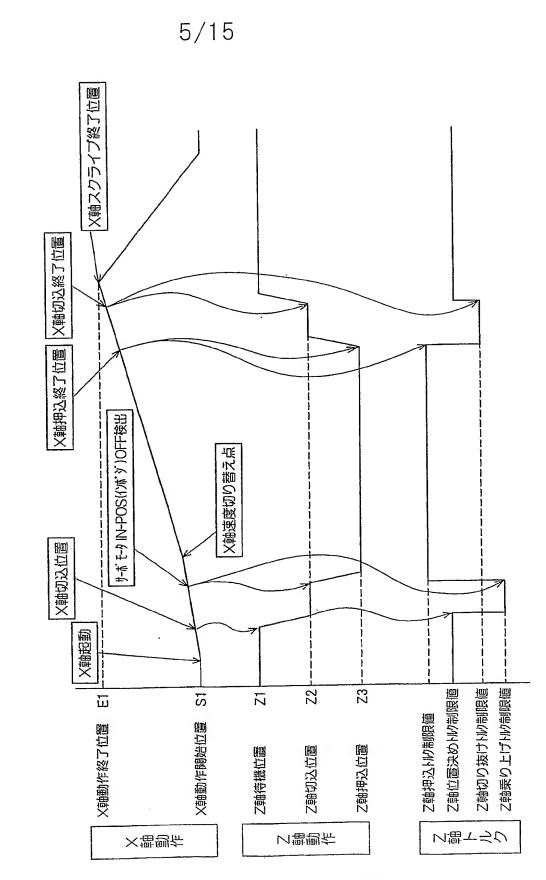




光恭之 田 w /#IPIIOA

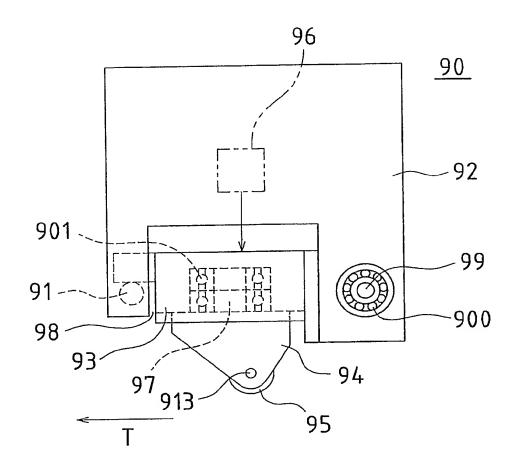


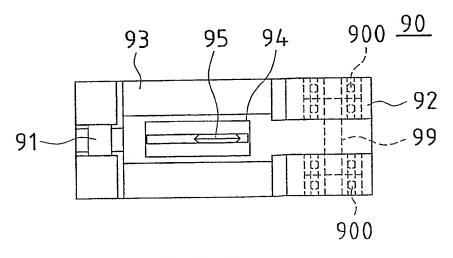
半 幹 7 田 (本 (田田)oで)



ANTERIA NA MINERAL & 44 AL

図9





坐 妹 > 田 娅 (却即196)

7/15



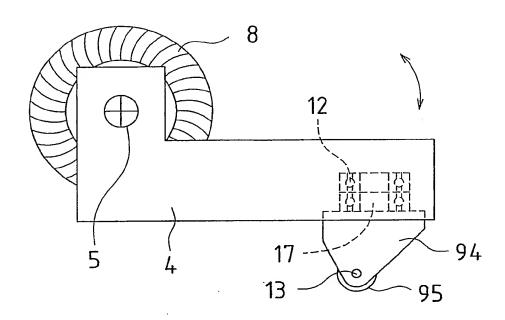
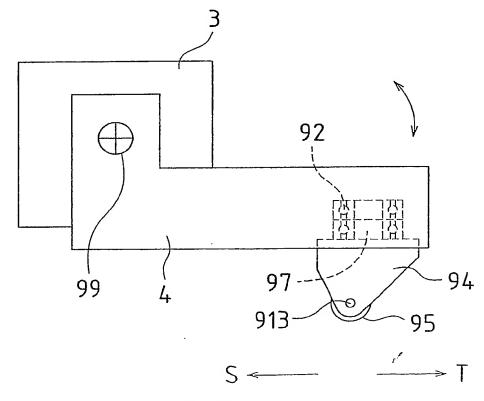
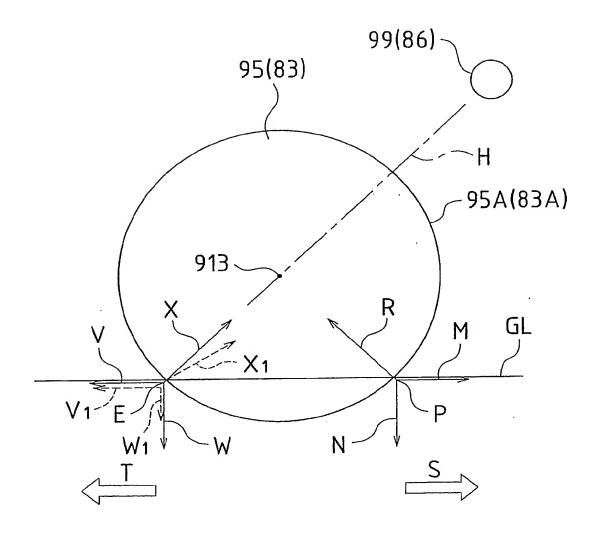


図12



الممانط عدر سد عد عد



PCT/JP02/07320

9/15

図14

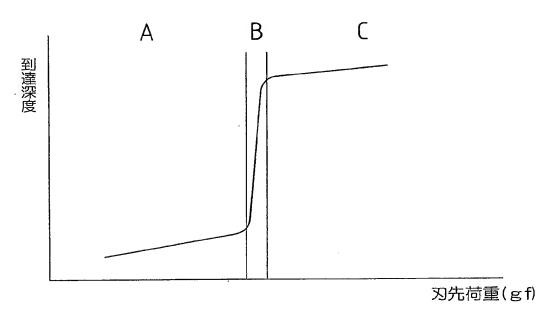
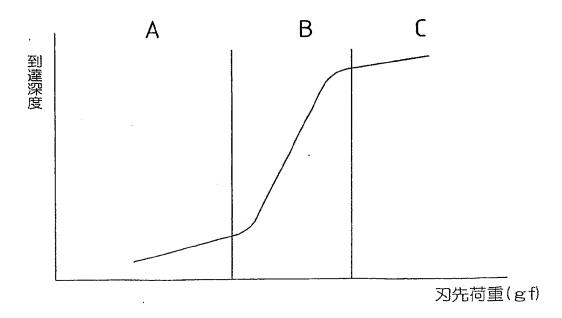


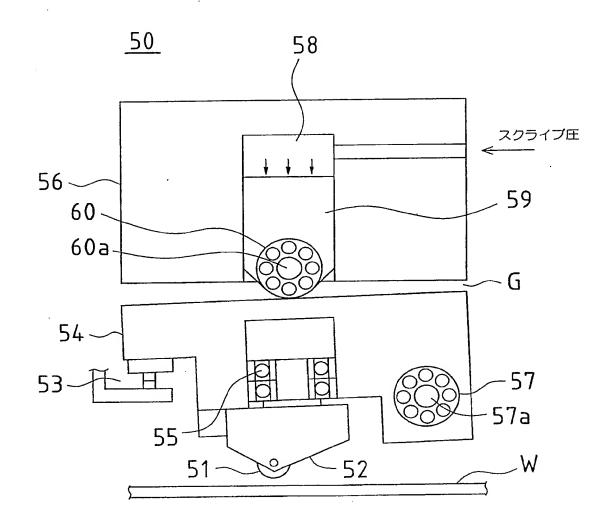
図15



尝 麸 > 田 納 (報則26)

10/15

図16

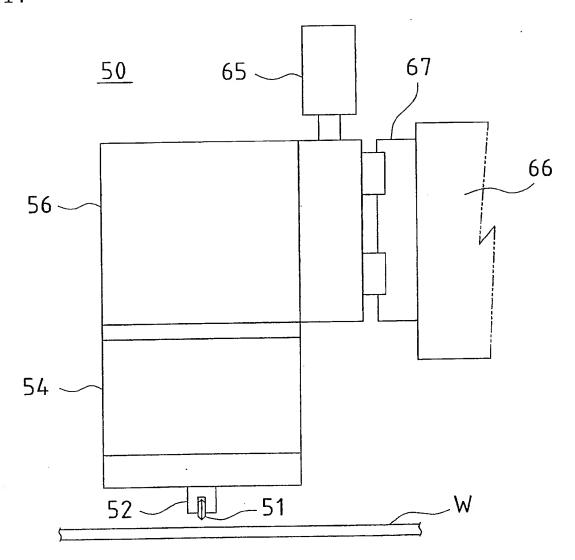


差替之用紙 (規則26)

PCT/JP02/07320

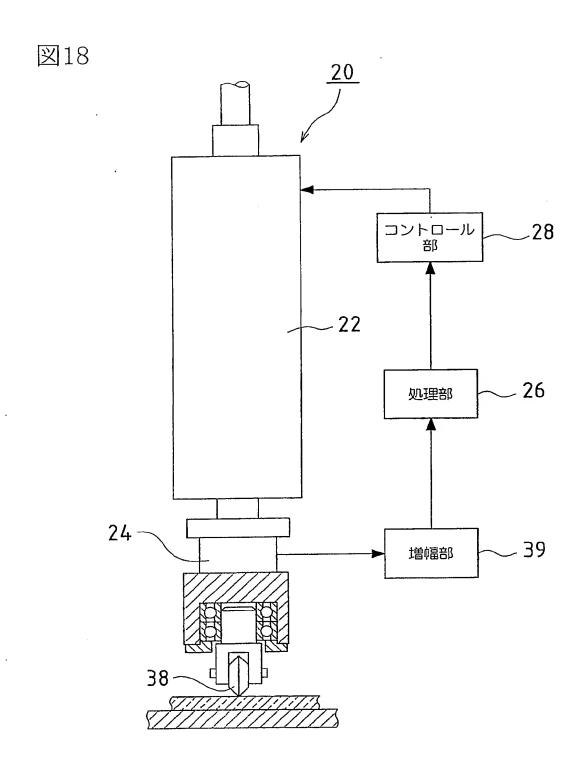
11/15

図17



.

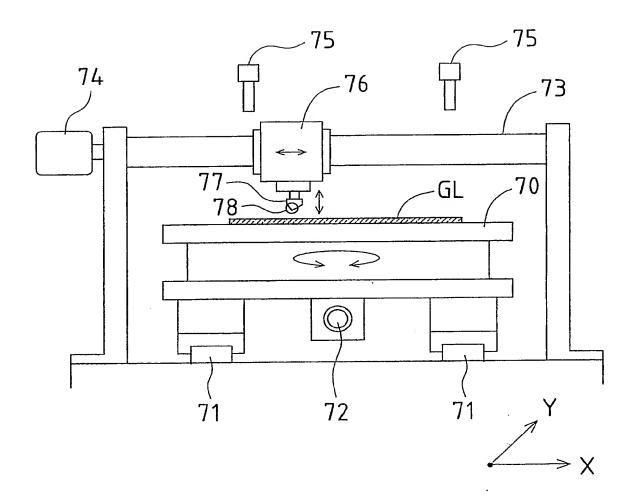
12/15



差替え用紙 (規則26)

13/15

図19



PCT/JP02/07320

14/15

図20

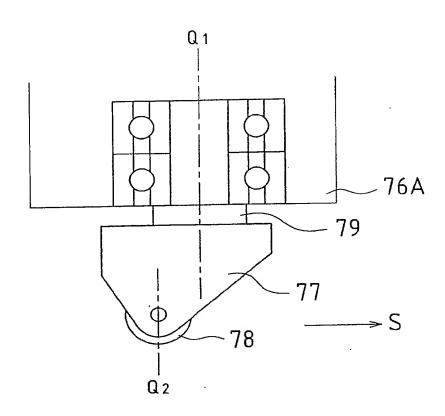
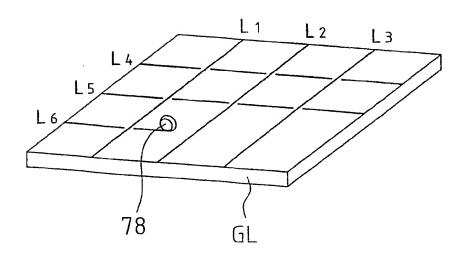


図21



WO 03/011777 PCT/JP02/07320

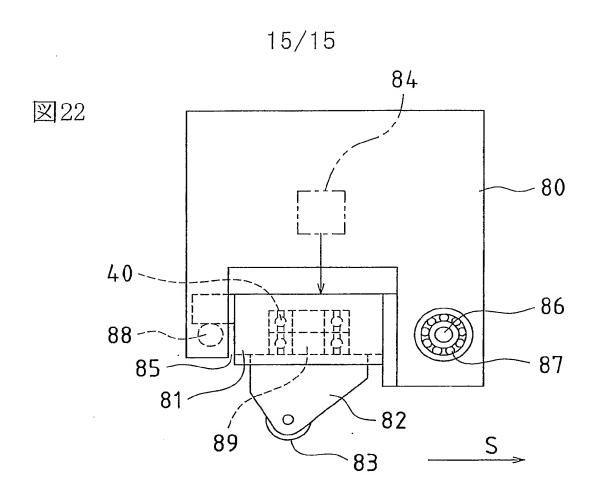
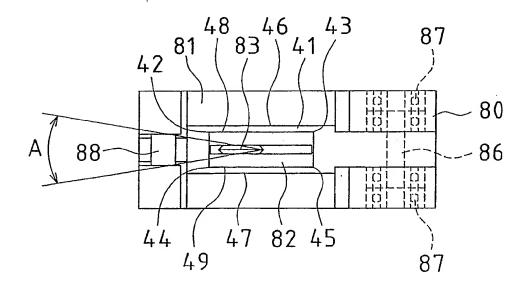


図23



差 恭 〉田 新 (粗則26)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/07320

			<u></u>		
A. CLASS Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ C03B33/027, H01L21/301				
According to	to International Patent Classification (IPC) or to both n	national classification and IPC			
	S SEARCHED				
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)			
Int.Cl ⁷ C03B33/027, C03B33/037					
	tion searched other than minimum documentation to th				
	uyo Shinan Koho 1926–1996				
Kokal	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002	Jitsuyo Shinan Toroku Koh	o 1996–2002		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
P, X	JP 2001-206727 A (Asahi Glas 31 July, 2001 (31.07.01), Page 2, column 1, lines 1 to to page 5, line 20; Figs. 1 (Family: none)	37; column 3, line 17	1-6		
X A	JP 2001-019452 A (Mitsuboshi Kabushiki Kaisha), 23 January, 2001 (23.01.01), Page 2, column 1, lines 1 to to page 4, column 6, line 7; (Family: none)	21; column 2, line 21	7,9,11-14, 16 8,10,15		
<u> </u>	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter priority date and not in conflict with th			
consider	red to be of particular relevance	understand the principle or theory under	erlying the invention		
	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the c considered novel or cannot be considered.	claimed invention cannot be		
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone	•		
	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step			
"O" docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such	documents, such		
than the	ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	combination being obvious to a person document member of the same patent fr	skilled in the art amily		
	ovember, 2002 (18.11.02)	Date of mailing of the international searce 03 December, 2002 (
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

		······································
C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant	
X A	JP 2000-247667 A (Mitsuboshi Diamond Kogyo Kabushiki Kaisha), 12 September, 2000 (12.09.00),	7,9,11-14, 16 8,10,15
4.4	Page 2, column 2, line 24 to page 3, column 3, line 17; Figs. 4 to 6 (Family: none)	0,10,10
х	JP 10-158022 A (Mitsuboshi Diamond Kogyo Kabushiki Kaisha),	7,9,11-14, 16
A	16 June, 1998 (16.06.98), Page 2, column 1, line 1 to column 2, line 8; page 4, column 5, line 18 to page 5, column 8, line 33; Figs. 8 to 15 (Family: none)	3,8,10,15
х	JP 2001-328833 A (Mitsuboshi Diamond Kogyo	7,9,11-14,
A	Kabushiki Kaisha), 27 November, 2001 (27.11.01), Full text; Figs. 1 to 13 (Family: none)	16 3,8,10,15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/07320

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: The "technical feature" of the group of invention of claims 1 to 6 and 8 to 12 is to lift/lower the scribe cutter and transmit the scribe pressure by using the rotation torque of the servo motor while the "technical feature" of the group of invention of claims 7 and 13 to 16 is the mounting mechanism of the cutter wheel chip onto the chip holder and the mounting mechanism of the chip holder onto the scribe head and this group does not refer to the servo motor which is the "technical feature" of the group of invention of claims 1 to 6 and 8 to 12. Consequently, claims 1 to 16 include two groups of inventions and these groups of inventions are not so linked as to form a single general inventive concept. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. X As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 C03B 33/027, H01L 21/301

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 7 CO3B 33/027, CO3B 33/037

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2002年

日本国登録実用新案公報

1994-2002年

日本国実用新案登録公報

1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
PX	JP 2001-206727 A(旭硝子株式会社),2001.07.31, 第2頁第1欄第1行-第37行,第2頁第3欄第17行-第5頁第20行, 図1-図8(ファミリーなし)	1-6	
x	JP 2001-019452 A(三星ダイヤモンド工業株式会社), 2001.01.23,第2頁第1欄第1行-第21行,第2頁第2欄第21行	7,9,11-14	
· A.	- 第4頁第6欄第7行,図3一図8(ファミリーなし)	, 16 8, 10, 15	

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

 国際調査を完了した日
 18.11.02
 国際調査報告の発送日
 03.12.02

 国際調査機関の名称及びあて先
 特許庁審査官(権限のある職員)
 4 T (を)

国際調査機関の名称及びあて完 日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 山 田 靖



4T 8116

電話番号 03-3581-1101 内線 3463

0 ((4.1)	BENEFIT AND A TOTAL AND A CONTRACT OF THE STATE OF THE ST	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	日に申ナフ
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する調求の範囲の番号
x	JP 2000-247667 A(三星ダイヤモンド工業株式会社), 2000.09.12,第2頁第2欄第24行-第3頁第3欄第17行,	7,9,11-14
A	図4-図6(ファミリーなし)	8, 10, 15
X	JP 10-158022 A(三星ダイヤモンド工業株式会社), 1998.06.16,第2頁第1欄第1行-第2欄第8行,	7,9,11-14 ,16
A	第4頁第5欄第18行一第5頁第8欄第33行, 図8-図15 (ファミリーなし)	3, 8, 10, 15
X	JP 2001-328833 A(三星ダイヤモンド工業株式会社), 2001.11.27,全文,図1-図13(ファミリーなし)	7,9,11-14 ,16
Α.		3, 8, 10, 15
	· ·	
	•	
	•	

第I欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について成しなかった。
1. □ 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 計求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第II欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲1~6,8~12に記載された発明の「技術的特徴」は、サーボモータの回転及び回転トルクを用い、スクライブカッターの昇降及びスクライブ圧の伝達を行うことであるのに対し、請求の範囲7,13~16に記載された発明の「技術的特徴」は、カッターホイルチップのチップホルダへの取付機構及びチップホルダのスクライブへッドへの取付機構であって、しかも、請求の範囲の1~6,8~12に記載された発明の「技術的特徴」であるサーボモータについては全く記載されていない。よって、請求の範囲1~16に記載された発明は、2つの発明を含んでおり、単一の一般的発明概念を形成しているものとは認められない。
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. 図 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. U 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
自加調 <u>在</u> 手数料の異議の申立てに関する注意
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。
□ ━/###■ 7 数/17 ℃ 111 ℃ 大に口傾入かり 発酸中止 くかなかった。